

2001年12月4日

### 最先端パッケージングおよび配線技術に関する戦略提携に参加

大日本スクリーン製造株式会社(本社:京都市上京区、社長:石田 明、以下:大日本スクリーン)はこのほど、日米欧の半導体装置およびプロセス開発のトップ企業で構成する最先端パッケージングおよび配線技術に関する戦略提携(略称:APiA)に発足メンバーの1社として参加することで合意しました。

この提携は、参加企業が技術と人的、財務的資源を提供してパッケージングと配線に関する技術を開発、半導体メーカーが容易に導入できるようにガイドラインを策定し、業界標準の確立を目指す試み。複雑化が進む最先端半導体チップのパッケージングに対応するため、バンププロセス、ウエハレベルチップサイズパッケージ(CSP)プロセスのソリューションを提供していきます。大日本スクリーンはレジスト塗布、現像および保護膜形成に関する技術で貢献します。

APiA は、こうした技術の実現のため、装置メーカーと顧客である半導体メーカーが最先端配線技術に関する問題点や要求について議論するフォーラムとしての役割を果たすとともに、技術、プロセスおよび市場情報を共有できる場として機能します。

300ミリウエハ対応の試作ラインを2002年にアメリカ、2003年にはアジアにそれぞれ設置し、デモンストレーションとプロセス技術の開発を行います。

参加企業は大日本スクリーンのほか、同提携の会長を務める Ultratech Stepper, Inc.(本社:米国・カリフォルニア州)、カシオ計算機株式会社(本社:東京都)、株式会社荏原製作所(本社:東京)、August Technology Corp.(本社:米国・ミネソタ州)、Flip Chip Division of Kuliche & Soffa(本社:米国・アリゾナ州)、Unaxis Balzers Ltd.(本社:スイス・チューリッヒ市)の7社。